SNx4ACT573 3 ステート出力、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ

1 特長

- 4.5V～5.5V の V_{CC} で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 t_{pd} 9.5ns (5V 時)
- 入力は TTL 電圧互換

2 アプリケーション

- パラレル データ ストレージ
- デジタル バス バッファ

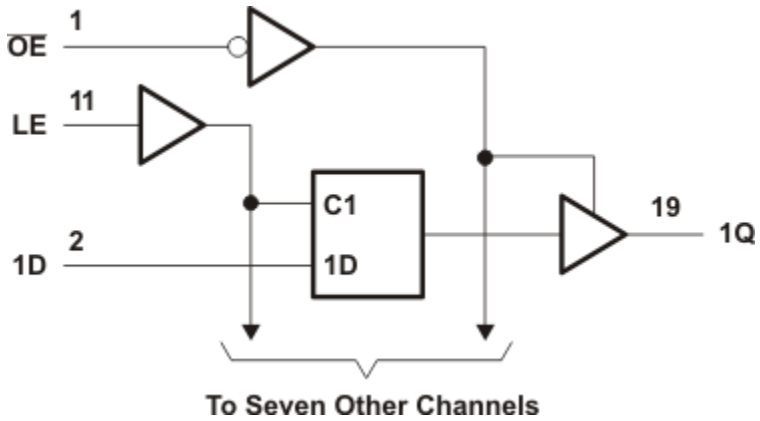
3 概要

これらの 8 ビット ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、バスドライバ、およびワーキング レジスタの実装に特に適しています。

製品情報

部品番号	定格	パッケージ (1)
SN54ACT573	軍事	J (CDIP、20)
		W (CFP、20)
		FK (LCCC、20)
SN74ACT573	カタログ	DB (SSOP、20)
		DW (SOIC、20)
		N (WQFN、20)
		NS (SOP、20)
		PW (TSSOP、20)
		RKS (VQFN、20)

(1) 詳細については、セクション 11 を参照してください。



論理図 (正論理)

このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

目次

1 特長.....1
2 アプリケーション.....1
3 概要.....1
4 ピン構成および機能.....3
5 仕様.....5
5.1 絶対最大定格.....5
5.2 推奨動作条件.....5
5.3 熱に関する情報.....5
5.4 電気的特性.....6
5.5 タイミング要件.....6
5.6 スイッチング特性.....7
5.7 動作特性.....7
6 パラメータ測定情報.....8
7 詳細説明.....9
7.1 概要.....9
7.2 機能ブロック図.....9
7.3 デバイスの機能モード.....9
8 アプリケーションと実装.....10
8.1 電源に関する推奨事項.....10
8.2 レイアウト.....10
9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....11
9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....11
9.2 サポート・リソース.....11
9.3 商標.....11
9.4 静電気放電に関する注意事項.....11
9.5 用語集.....11
10 改訂履歴.....11
11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....11

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

4 ピン構成および機能

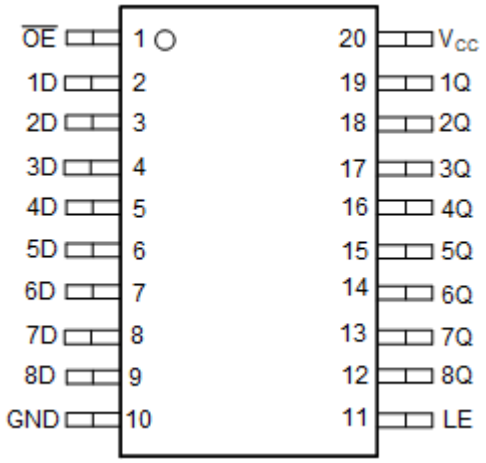


図 4-1. SN54ACT573 J または W パッケージ、SN74ACT573 DB、DW、N、NS、または PW パッケージ (上面図)

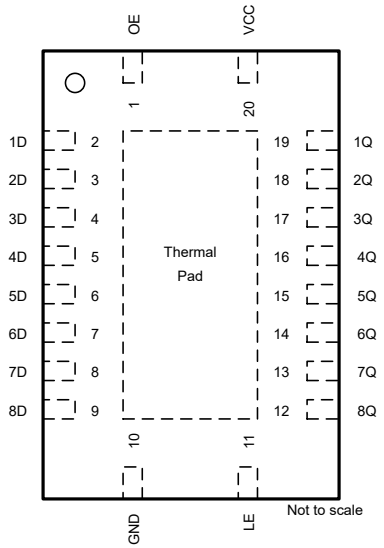


図 4-2. SNx4ACT573 RKS パッケージ、20 ピン VQFN (上面図)

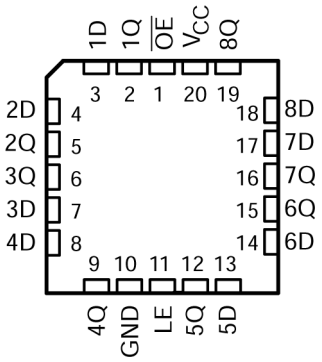


図 4-3. SN54ACT573 FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		種類 (1)	説明
名称	番号		
$\overline{OE}$	1	I	出力イネーブル
1D	2	I	1D 入力
2D	3	I	2D 入力
3D	4	I	3D 入力
4D	5	I	4D 入力
5D	6	I	5D 入力
6D	7	I	6D 入力
7D	8	I	7D 入力
8D	9	I	8D 入力
GND	10	—	グランド
LE	11	I	ラッチ イネーブル入力
8Q	12	O	8Q 出力
7Q	13	O	7Q 出力
6Q	14	O	6Q 出力
5Q	15	O	5Q 出力
4Q	16	O	4Q 出力
3Q	17	O	3Q 出力
2Q	18	O	2Q 出力
1Q	19	O	1Q 出力
V_{CC}	20	—	パワー・ピン
サーマル パッド (2)		—	サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、P = 電源。
(2) RKS パッケージのみ。

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)[1]

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲		-0.5	7	V
V_I [(2)]	入力電圧範囲		-0.5	V_{CC} + 0.5	V
V_O [(2)]	出力電圧範囲		-0.5	V_{CC} + 0.5	V
I_{IK}	入力クランプ電流	(V_I < 0 または V_I > V_{CC})		±20	mA
I_{OK}	出力クランプ電流	(V_O < 0 または V_O > V_{CC})		±20	mA
I_O	連続出力電流	(V_O = 0～V_{CC})		±50	mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流			±200	mA
T_{stg}	保管温度範囲		-65	150	℃

(1) 「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、データシートの「推奨動作条件」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正しく動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
(2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

5.2 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)1

		SN54ACT573		SN74ACT573		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	
V_{CC}	電源電圧	4.5	5.5	4.5	5.5	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	2		2		V
V_{IL}	Low レベル入力電圧		0.8		0.8	V
V_I	入力電圧	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
V_O	出力電圧	0	V_{CC}	0	V_{CC}	V
I_{OH}	High レベル出力電流		–24		–24	mA
I_{OL}	Low レベル出力電流		24		24	mA
Δt/Δv	入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート		8		8	ns/V
T_A	自由気流での動作温度	-55	125	-40	85	℃

5.3 熱に関する情報

熱評価基準		SN74ACT573						単位
		DW (SOIC)	DB (SSOP)	N (PDIP)	NS (SO)	PW (TSSOP)	RKS (VQFN)	
		20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	20 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗 [(1)]	101.2	70	69	60	126.2	67.7	℃/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション レポートを参照してください。

5.4 電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V_{CC}	T_A = 25℃			SN54ACT573		SN74ACT573		単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
V_{OH}	I_{OH} = -50μA	4.5V	4.4	4.49		4.4		4.4		V
		5.5V	5.4	5.49		5.4		5.4		
	I_{OH} = -24mA	4.5V	3.86			3.7		3.76		
		5.5V	4.86			4.7		4.76		
	I_{OH} = -50 mA(1)	5.5V				3.85				
	I_{OH} = -75 mA(1)	5.5V						3.85		
V_{OL}	I_{OL} = 50μA	4.5V			0.1		0.1		0.1	V
		5.5V			0.1		0.1		0.1	
	I_{OL} = 24 mA	4.5V			0.36		0.44		0.44	
		5.5V			0.36		0.44		0.44	
	I_{OL} = 50mA(1)	5.5V					1.65			
	I_{OL} = 75mA(1)	5.5V							1.65	
I_{OZ}	V_O = V_{CC} または GND	5.5V			±0.25		±5		±2.5	μA
I_I	V_I = V_{CC} または GND	5.5V			±0.1		±1		±1	μA
I_{CC}	V_I = V_{CC} または GND、 I_O = 0	5.5V			4		80		40	μA
ΔI_{CC} (2)	1 つの入力は 3.4V、 他の入力は GND または V_{CC}	5.5V		0.6			1.5		1.5	mA
C_i	V_I = V_{CC} または GND	5V		5						pF

(1) 一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 2ms を超えないようにしてください。
(2) これは、0V や V_{CC} ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。

5.5 タイミング要件

自由気流での動作温度範囲内、V_{CC} = 5V ± 0.5V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

		T_A = 25℃		SN54ACT573		SN74ACT573		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_w	パルス幅、LE High	3.5		5		4		ns
t_{su}	セットアップ時間、LE ↓ 前のデータ	3		4.5		3.5		ns
t_h	ホールド時間、LE ↓ 後のデータ	0		1		0		ns

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

5.6 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内、V_{CC} = 5V ± 0.5V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)

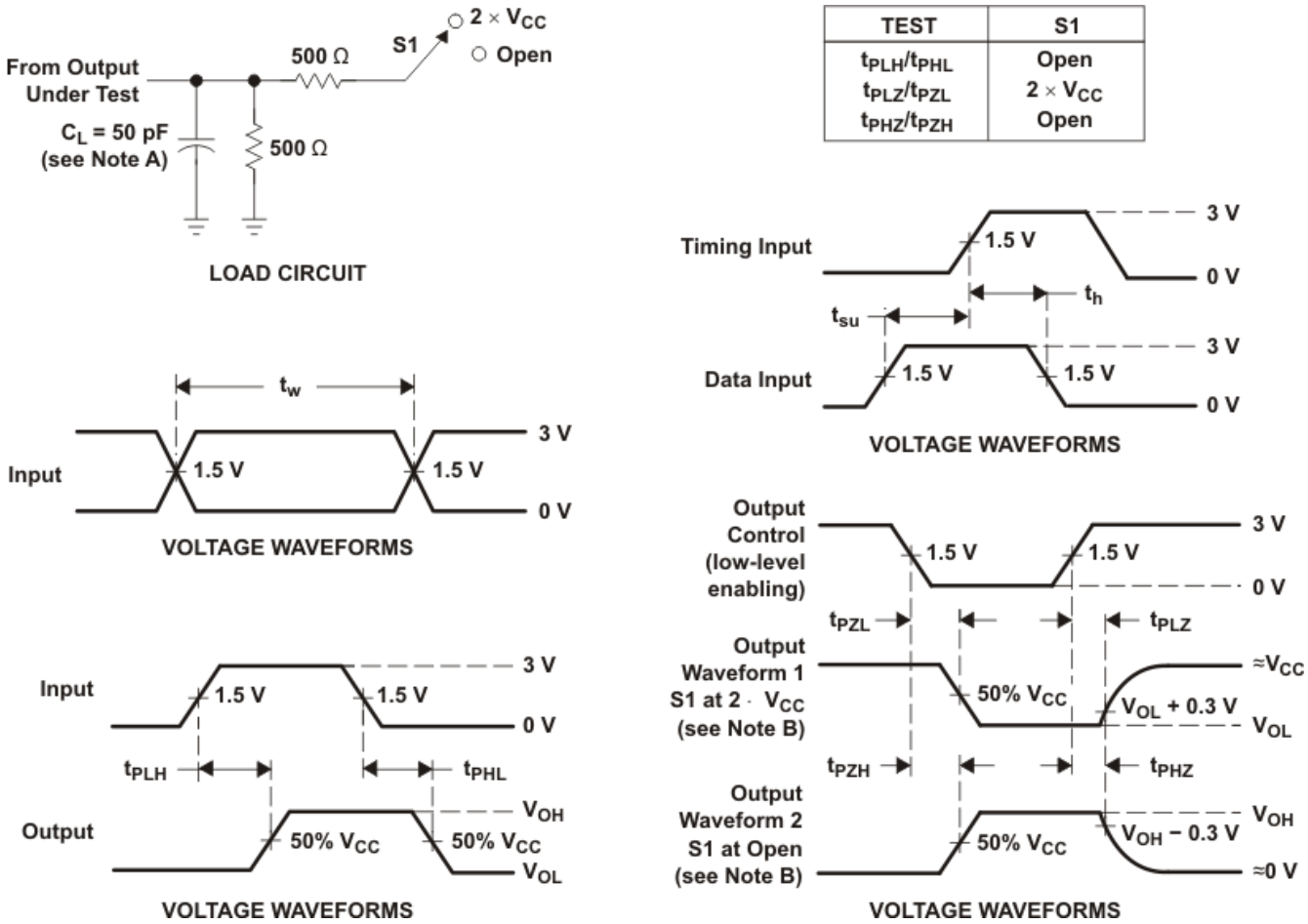
パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	T_A = 25℃			SN54ACT573		SN74ACT573		単位
			最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t_{PLH}	D	Q	2.5	6	10.5	1.5	13.5	2	12	ns
t_{PHL}			2.5	6	10.5	1.5	13.5	2	12	
t_{PLH}	LE	Q	3	6	10.5	1.5	13	2.5	12	ns
t_{PHL}			2.5	5.5	9.5	1.5	12	2	10.5	
t_{PZH}	OE	Q	2	5.5	10	1.5	11.5	1.5	11	ns
t_{PZL}			1.5	5.5	9.5	1.5	11	1.5	10.5	
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	2.5	6.5	11	1.5	13.5	1.5	12.5	ns
t_{PLZ}			1.5	5	8.5	1.5	10.5	1	9.5	

5.7 動作特性

V_{CC} = 5V、T_A = 25℃

パラメータ	テスト条件	標準値	単位
C_{pd} 電力散逸容量	C_L = 50pF、 f = 1MHz	25	pF

6 パラメータ測定情報



TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	2 × V_{CC}
t_{PHZ}/t_{PZH}	Open

A. C_L にはプローブと治具の容量が含まれます。

B. 波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。

C. すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 1MHz、Z_O = 50Ω、t_r ≦ 2.5ns、t_f ≦ 2.5ns。

D. 出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

図 6-1. 負荷回路および電圧波形

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

7 詳細説明

7.1 概要

8 つのラッチは D タイプのトランスペアレント ラッチです。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力で設定されたロジック・レベルで Q 出力がラッチされます。

バッファ付きの出力イネーブル ($\overline{OE}$) 入力を使用して、8 つの出力を通常のロジック状態 (High または Low ロジック レベル) または高インピーダンス状態のいずれかにできます。高インピーダンス状態では、出力によってバス ラインに大きな負荷がかかったり、駆動されたりしません。高インピーダンス状態と駆動性能の向上によって、インターフェイスまたはプルアップ コンポーネントなしでバス ラインの駆動が可能になります。

$\overline{OE}$ は、ラッチの内部動作に影響しません。出力が高インピーダンス状態にある間に、古いデータを保持することも新しいデータを入力することもできます。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、$\overline{OE}$ をプルアップ抵抗を介して V_{CC} に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決まります。

7.2 機能ブロック図

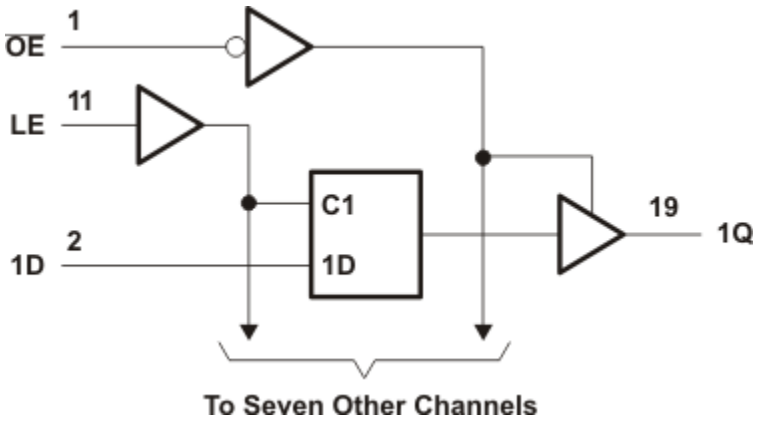


図 7-1. 論理図 (正論理)

7.3 デバイスの機能モード

機能表
(各ラッチ)

入力			出力
$\overline{OE}$	LE	D	Q
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q_0
H	X	X	Z

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 電源に関する推奨事項

電源には、「セクション 5.2」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の外乱を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単電源のデバイスには 0.1μF を推奨します。V_{CC} 端子が複数ある場合は、各電源端子に 0.01μF または 0.022μF を推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。一般的に、0.1μF と 1μF を並列に使用します。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

8.2 レイアウト

8.2.1 レイアウトのガイドライン

多ビット ロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングにしないでください。

多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用したり、4 つのバッファ ゲートのうち 3 つのみを使用したりする場合)。このような入力ピンを未接続のままにしないでください。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。以下に規定された規則は、あらゆる状況で遵守する必要があります。デジタル ロジック デバイスの未使用の入力はすべて、フローティングにならないように、High または Low バイアスに接続する必要があります。特定の未使用の入力に対して適用が必要となるロジック レベルは、デバイスの機能により異なります。一般に、GND または V_{CC} のうち、より適切であるかより利便性の高い方に接続されます。本部品がトランシーバでない限り、一般的に、出力をフローティングにすることが許容されます。トランシーバに出力イネーブル ピンがある場合、アサートされると本部品の出力セクションがディセーブルになります。これによって IO の入力セクションはディスエーブルされないため、ディスエーブル時にもフローティングにできません。

8.2.2 レイアウト例

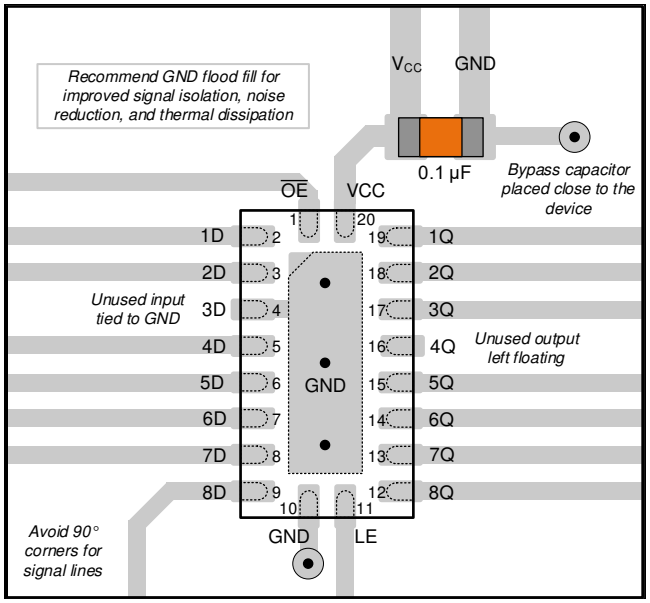


図 8-1. SNx4ACT573 のレイアウト例

Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。 変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの使用条件を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項

この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (November 2023) to Revision G (March 2024)	Page
• RθJA の値を更新：DW = 58～101.2、PW = 83～126.2、値はすべて℃/W 単位	5
• 「アプリケーションと実装」セクションを追加	10

Changes from Revision E (August 2023) to Revision F (November 2023)	Page
• RKS パッケージ情報を追加	1
• 定格を含めるよう「製品情報」表を更新	1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用している場合は、画面左側のナビゲーションをご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
5962-87664012A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87664012A SNJ54ACT573FK
5962-8766401RA	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401RA SNJ54ACT573J
5962-8766401SA	Active	Production	CFP (W) | 20	25 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401SA SNJ54ACT573W
SN74ACT573DBR	Active	Production	SSOP (DB) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD573
SN74ACT573DBR.A	Active	Production	SSOP (DB) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD573
SN74ACT573DW	Obsolete	Production	SOIC (DW) | 20	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	ACT573
SN74ACT573DWR	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT573
SN74ACT573DWR.A	Active	Production	SOIC (DW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT573
SN74ACT573N	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN74ACT573N
SN74ACT573N.A	Active	Production	PDIP (N) | 20	20 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	SN74ACT573N
SN74ACT573NSR	Active	Production	SOP (NS) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT573
SN74ACT573NSR.A	Active	Production	SOP (NS) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	ACT573
SN74ACT573PW	Obsolete	Production	TSSOP (PW) | 20	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	AD573
SN74ACT573PWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD573
SN74ACT573PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 20	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AD573
SN74ACT573RKSR	Active	Production	VQFN (RKS) | 20	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	ACT573
SN74ACT573RKSR.A	Active	Production	VQFN (RKS) | 20	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	ACT573
SNJ54ACT573FK	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87664012A SNJ54ACT573FK
SNJ54ACT573FK.A	Active	Production	LCCC (FK) | 20	55 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-87664012A SNJ54ACT573FK
SNJ54ACT573J	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401RA SNJ54ACT573J

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SNJ54ACT573J.A	Active	Production	CDIP (J) | 20	20 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401RA SNJ54ACT573J
SNJ54ACT573W	Active	Production	CFP (W) | 20	25 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401SA SNJ54ACT573W
SNJ54ACT573W.A	Active	Production	CFP (W) | 20	25 | TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	5962-8766401SA SNJ54ACT573W

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN54ACT573, SN74ACT573 :

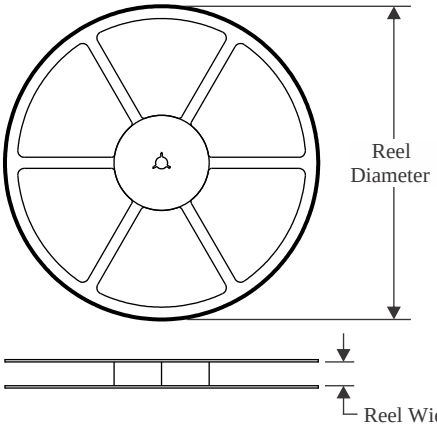
- Catalog : SN74ACT573
- Automotive : SN74ACT573-Q1, SN74ACT573-Q1
- Military : SN54ACT573

NOTE: Qualified Version Definitions:

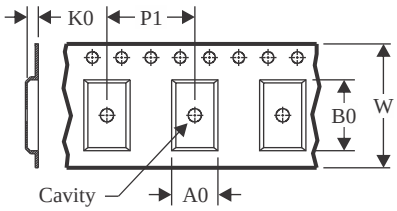
- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

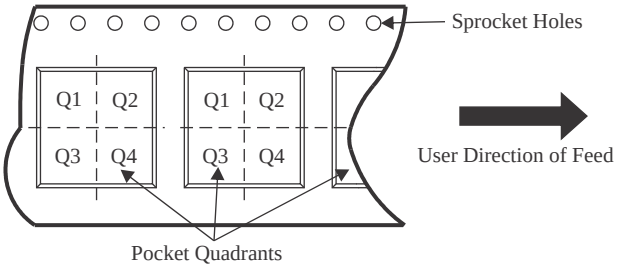


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

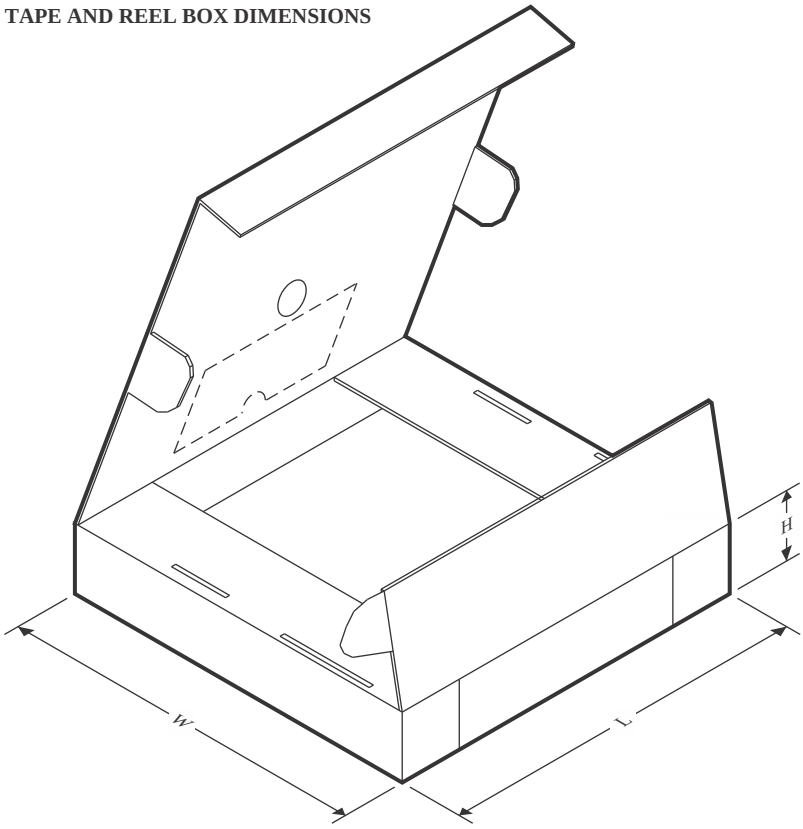
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74ACT573DBR	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74ACT573DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74ACT573DWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.9	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74ACT573NSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74ACT573PWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74ACT573RKSR	VQFN	RKS	20	3000	180.0	12.4	2.8	4.8	1.2	4.0	12.0	Q1

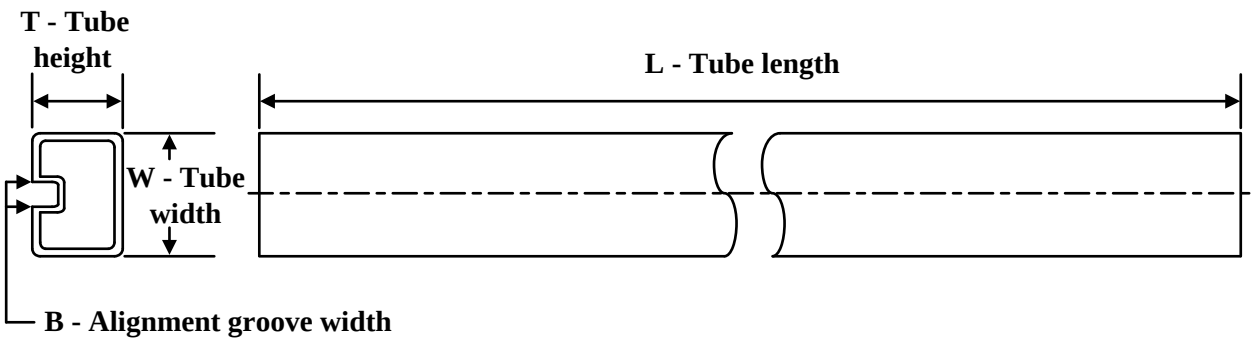
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

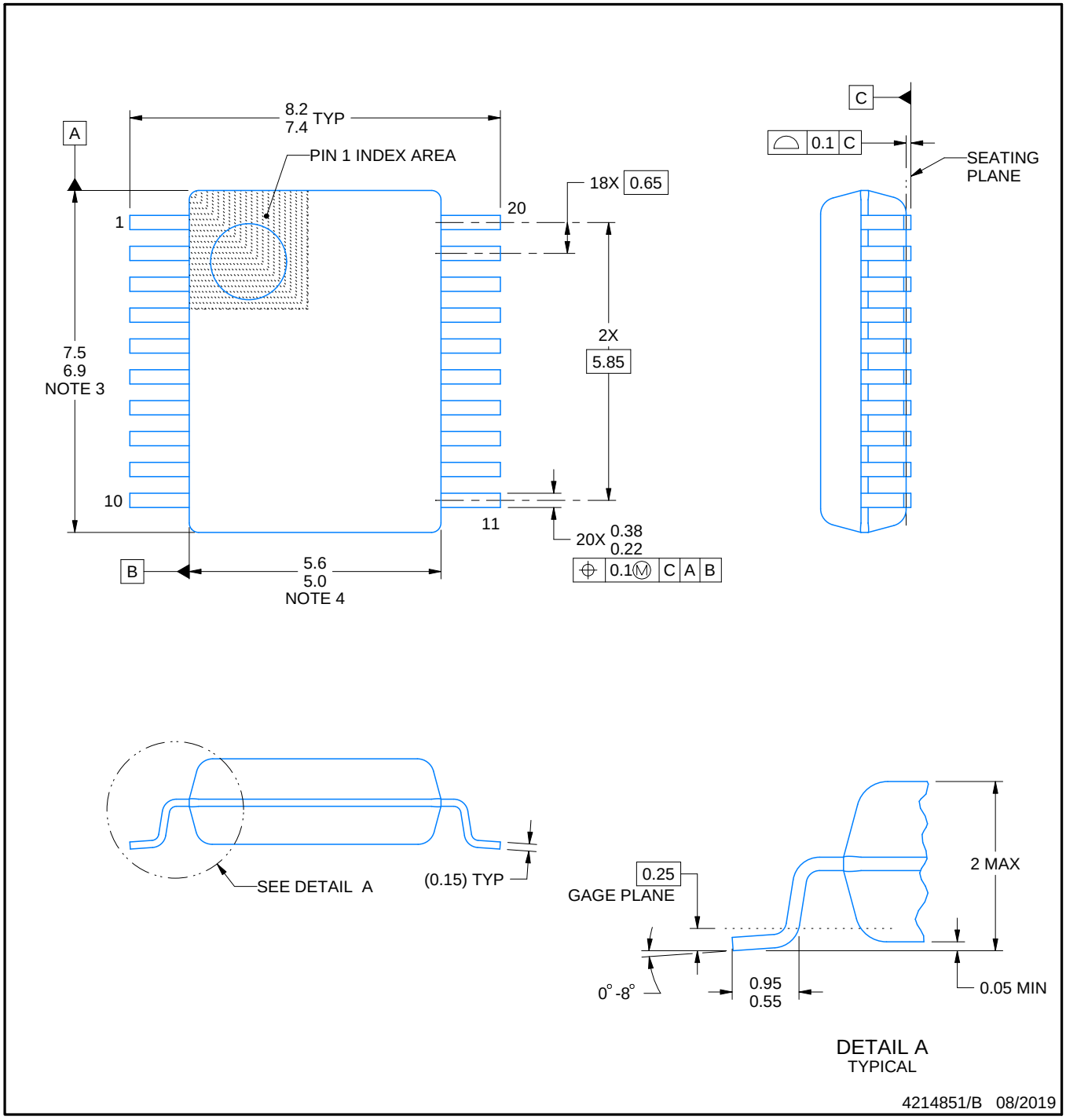
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74ACT573DBR	SSOP	DB	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74ACT573DWR	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
SN74ACT573DWR	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
SN74ACT573NSR	SOP	NS	20	2000	356.0	356.0	45.0
SN74ACT573PWR	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74ACT573RKSR	VQFN	RKS	20	3000	210.0	185.0	35.0

TUBE



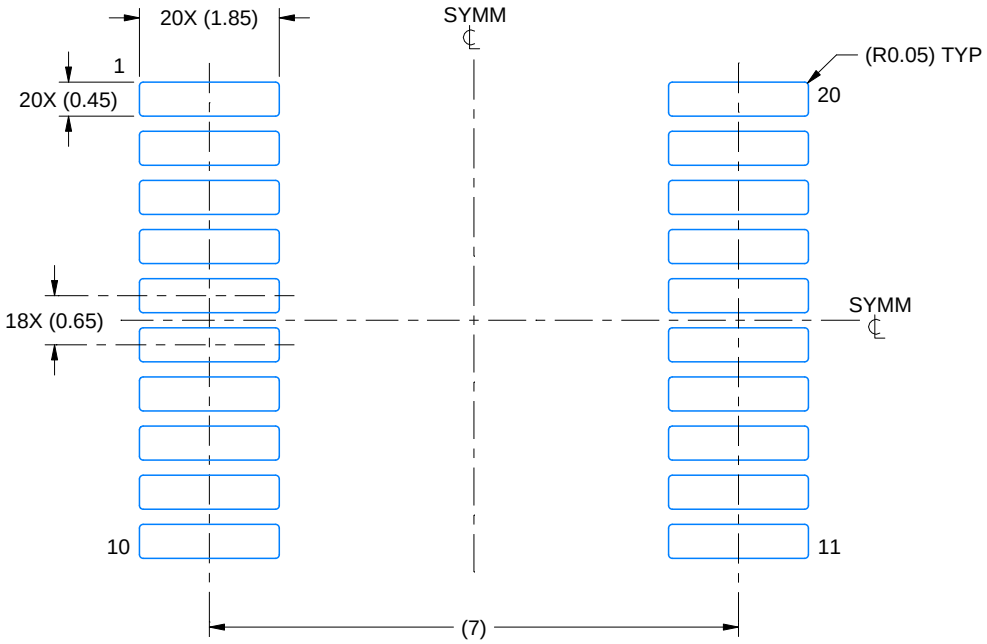
*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
5962-87664012A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
5962-8766401SA	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
SN74ACT573N	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SN74ACT573N.A	N	PDIP	20	20	506	13.97	11230	4.32
SNJ54ACT573FK	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54ACT573FK.A	FK	LCCC	20	55	506.98	12.06	2030	NA
SNJ54ACT573W	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA
SNJ54ACT573W.A	W	CFP	20	25	506.98	26.16	6220	NA

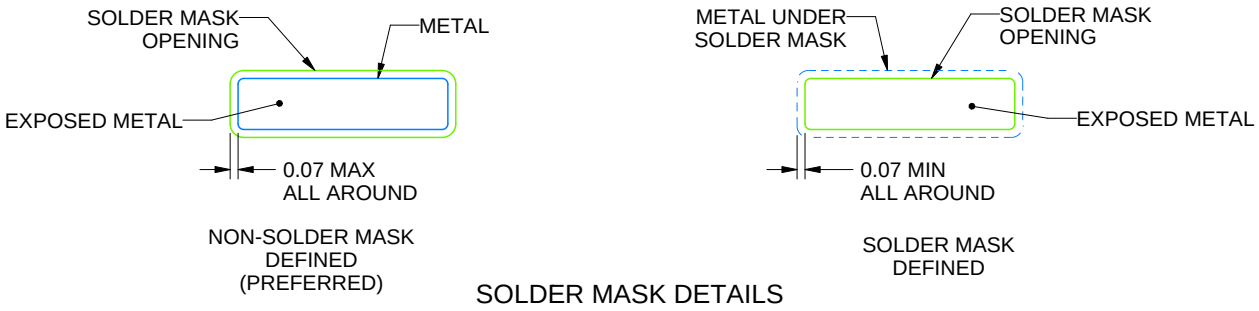


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

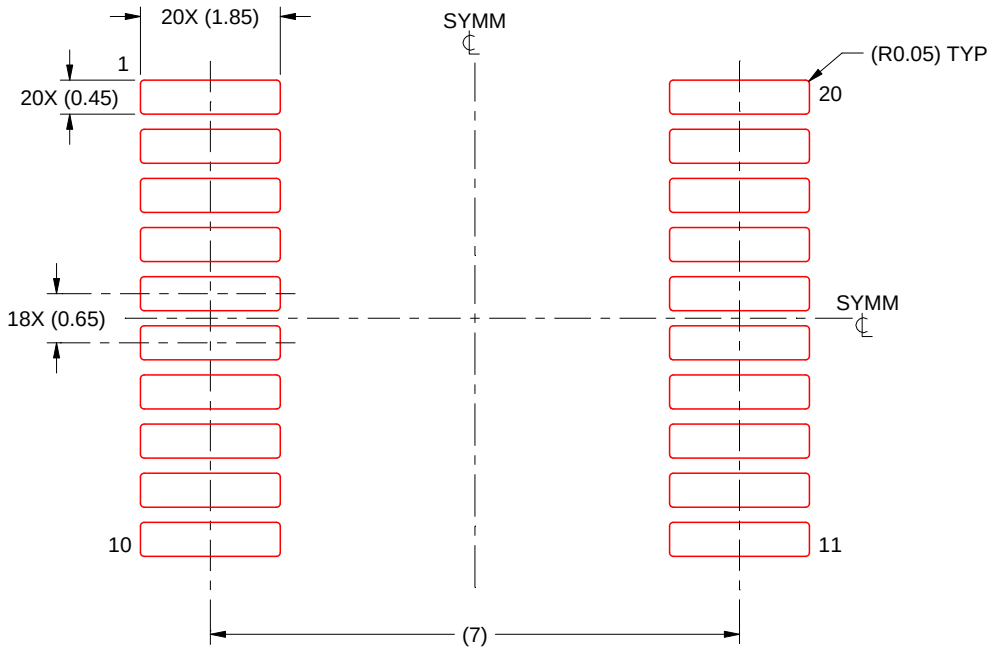


SOLDER MASK DETAILS

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

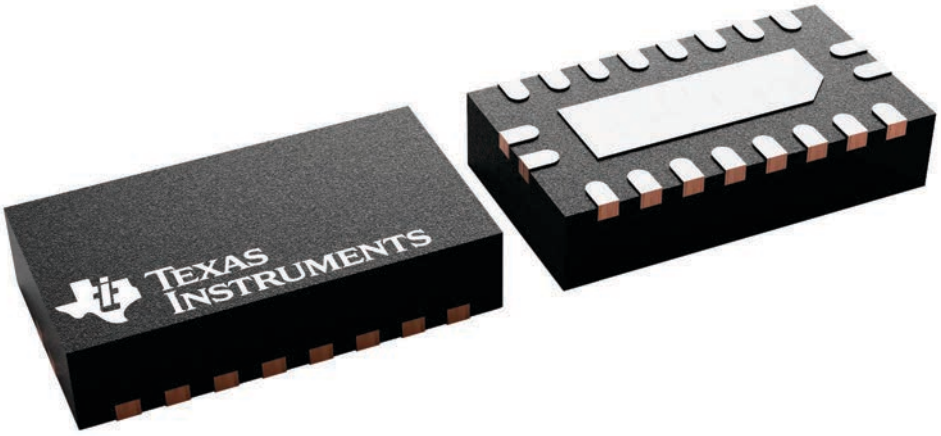
RKS 20

VQFN - 1 mm max height

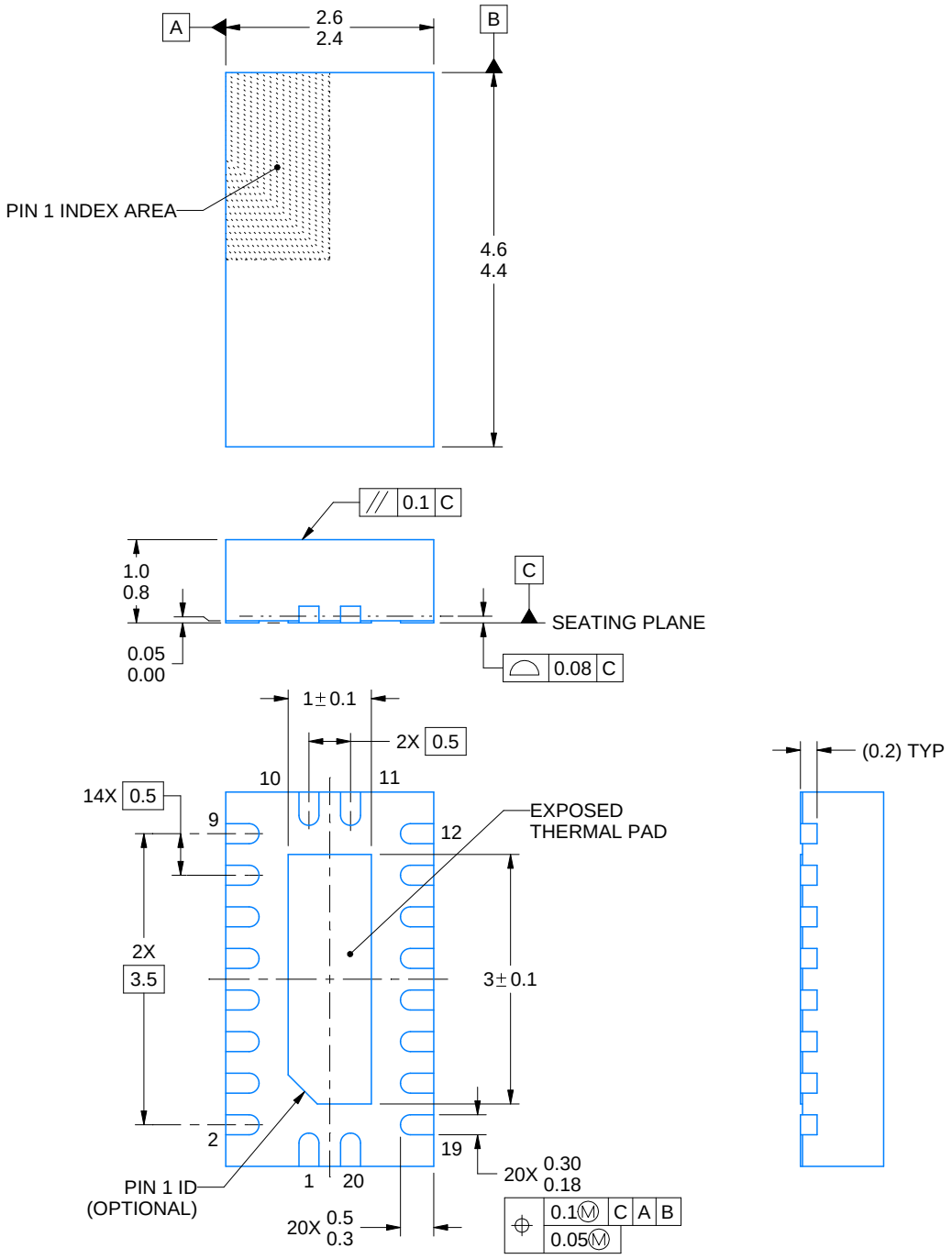
2.5 x 4.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



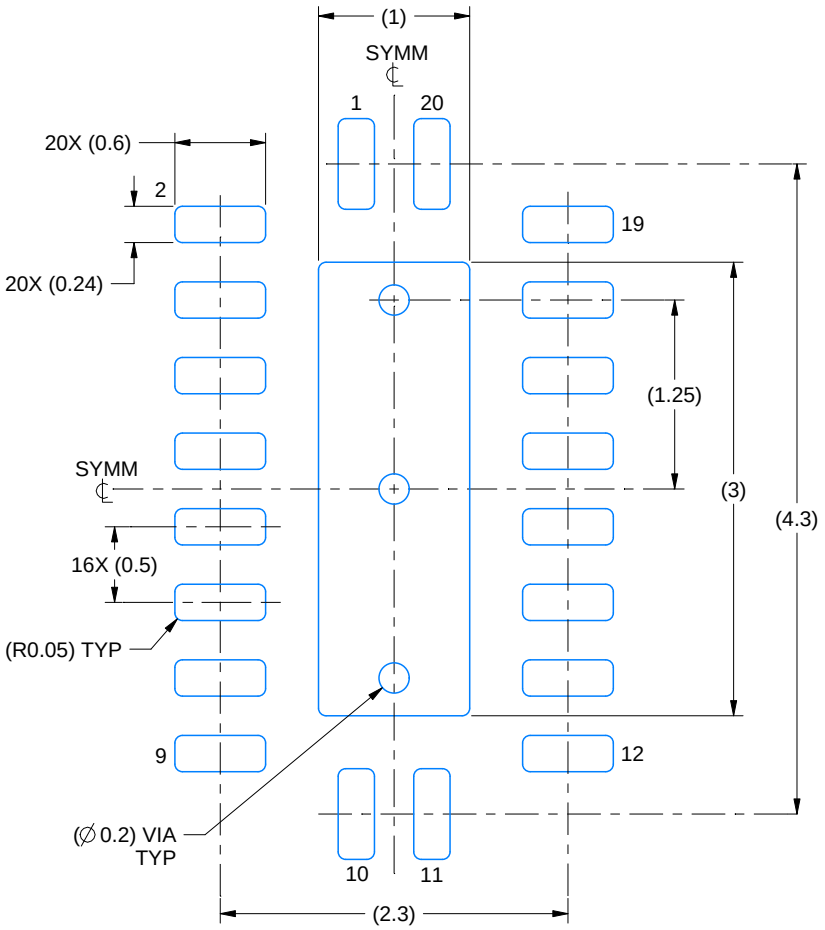
4226872/A



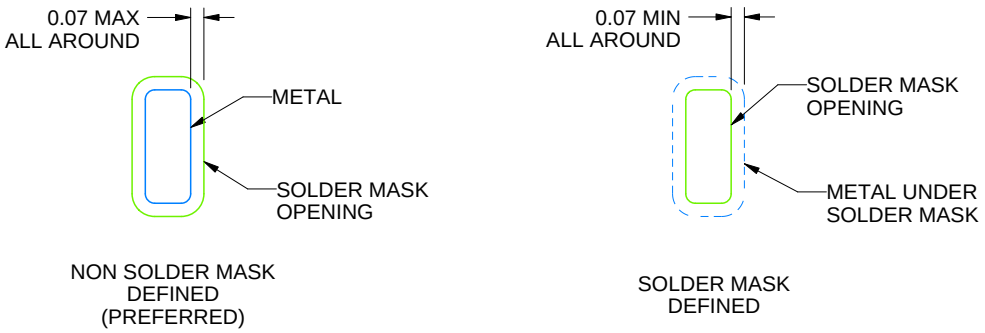
4222490/B 02/2021

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:20X

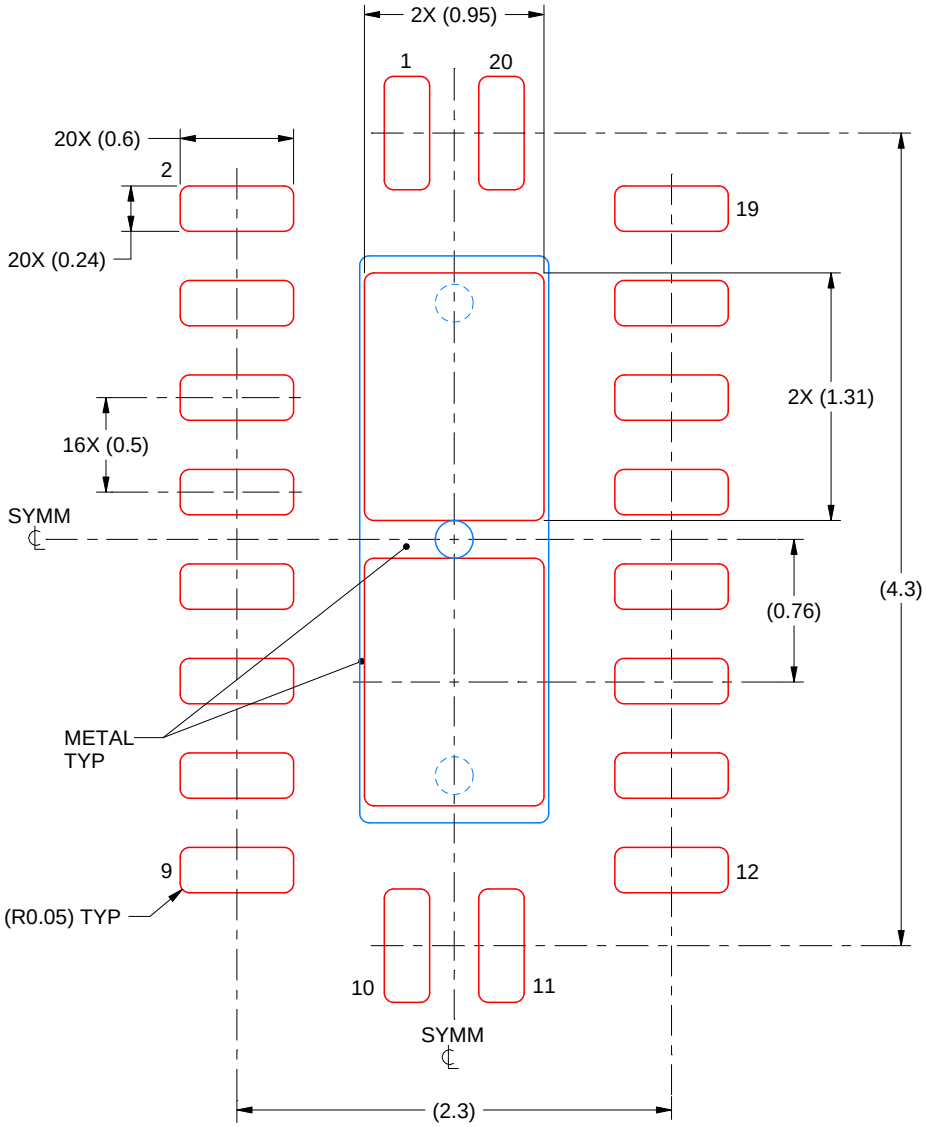


SOLDER MASK DETAILS

4222490/B 02/2021

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If some or all are implemented, recommended via locations are shown.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
83% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:25X

4222490/B 02/2021

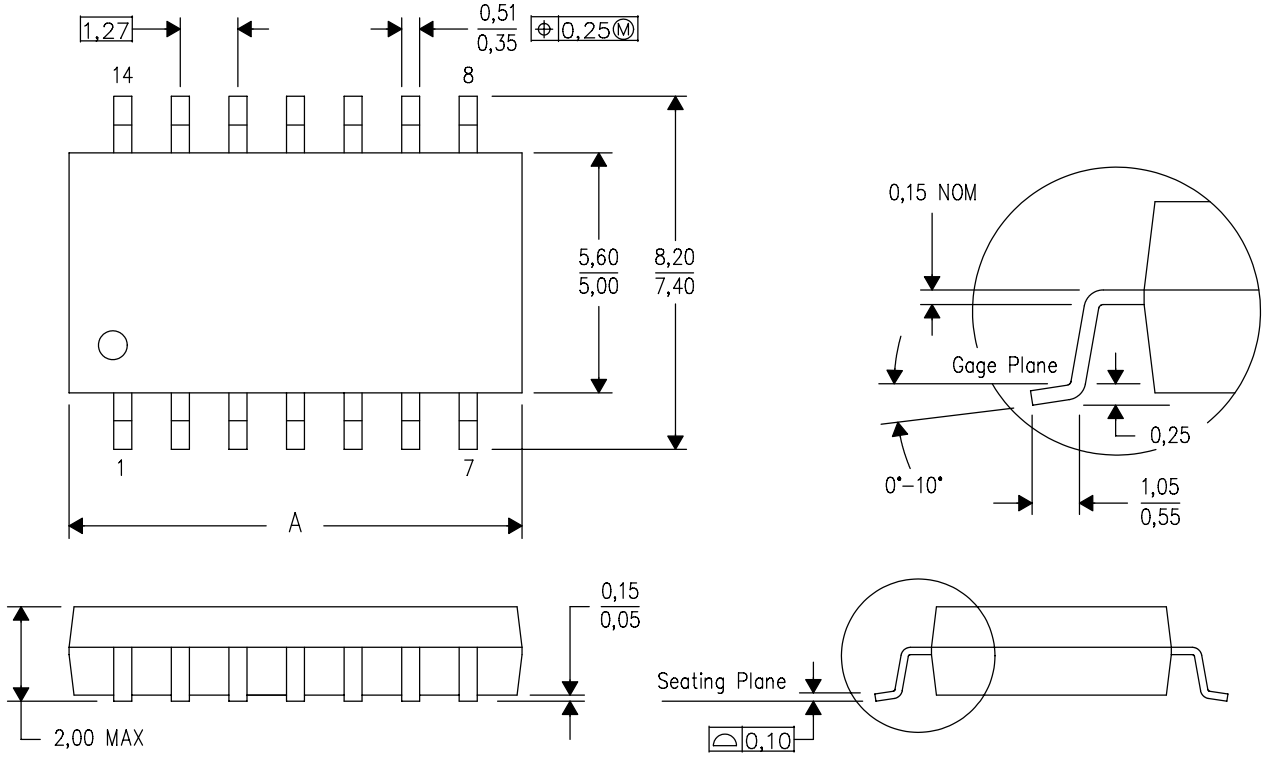
NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G)** **PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE**

14-PINS SHOWN



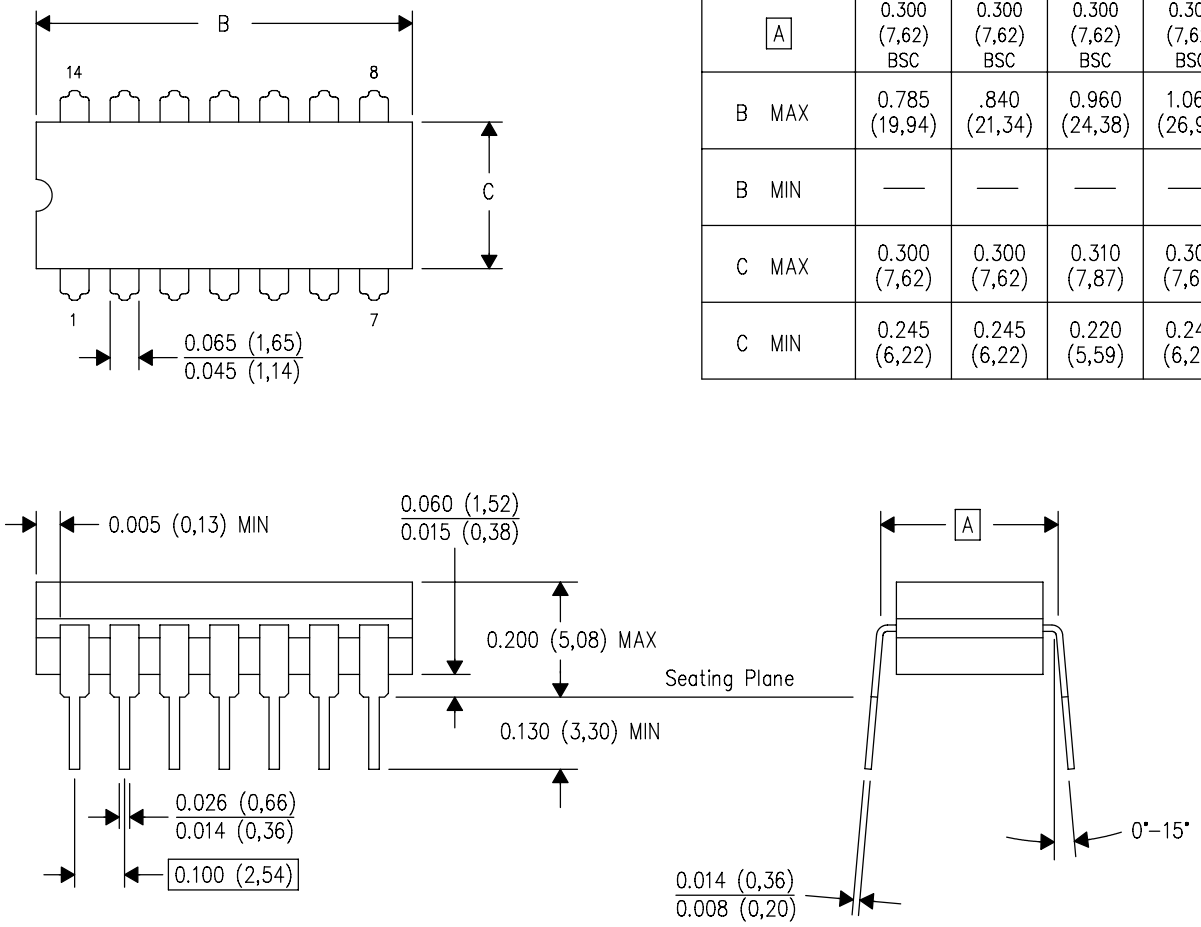
DIM \ PINS **	14	16	20	24
A MAX	10,50	10,50	12,90	15,30
A MIN	9,90	9,90	12,30	14,70

4040062/C 03/03

NOTES:
A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

J (R–GDIP–T**) CERAMIC DUAL IN–LINE PACKAGE

14 LEADS SHOWN



DIM \ PINS **	14	16	18	20
A	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC	0.300 (7,62) BSC
B MAX	0.785 (19,94)	.840 (21,34)	0.960 (24,38)	1.060 (26,92)
B MIN	—	—	—	—
C MAX	0.300 (7,62)	0.300 (7,62)	0.310 (7,87)	0.300 (7,62)
C MIN	0.245 (6,22)	0.245 (6,22)	0.220 (5,59)	0.245 (6,22)

4040083/F 03/03

NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
- D. Index point is provided on cap for terminal identification only on press ceramic glass frit seal only.
- E. Falls within MIL STD 1835 GDIP1–T14, GDIP1–T16, GDIP1–T18 and GDIP1–T20.

GENERIC PACKAGE VIEW

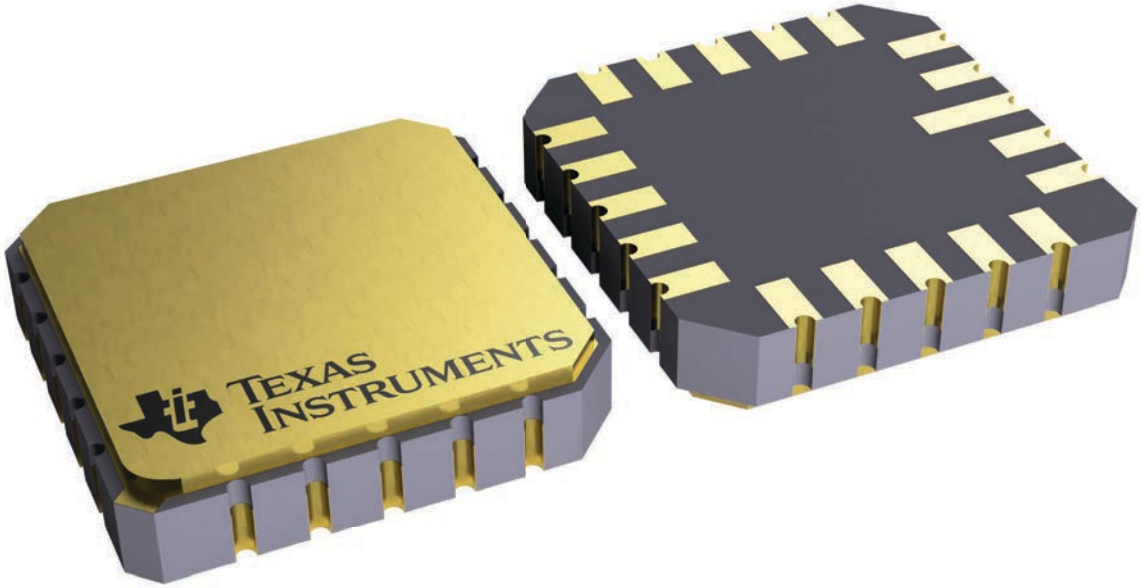
FK 20

LCCC - 2.03 mm max height

8.89 x 8.89, 1.27 mm pitch

LEADLESS CERAMIC CHIP CARRIER

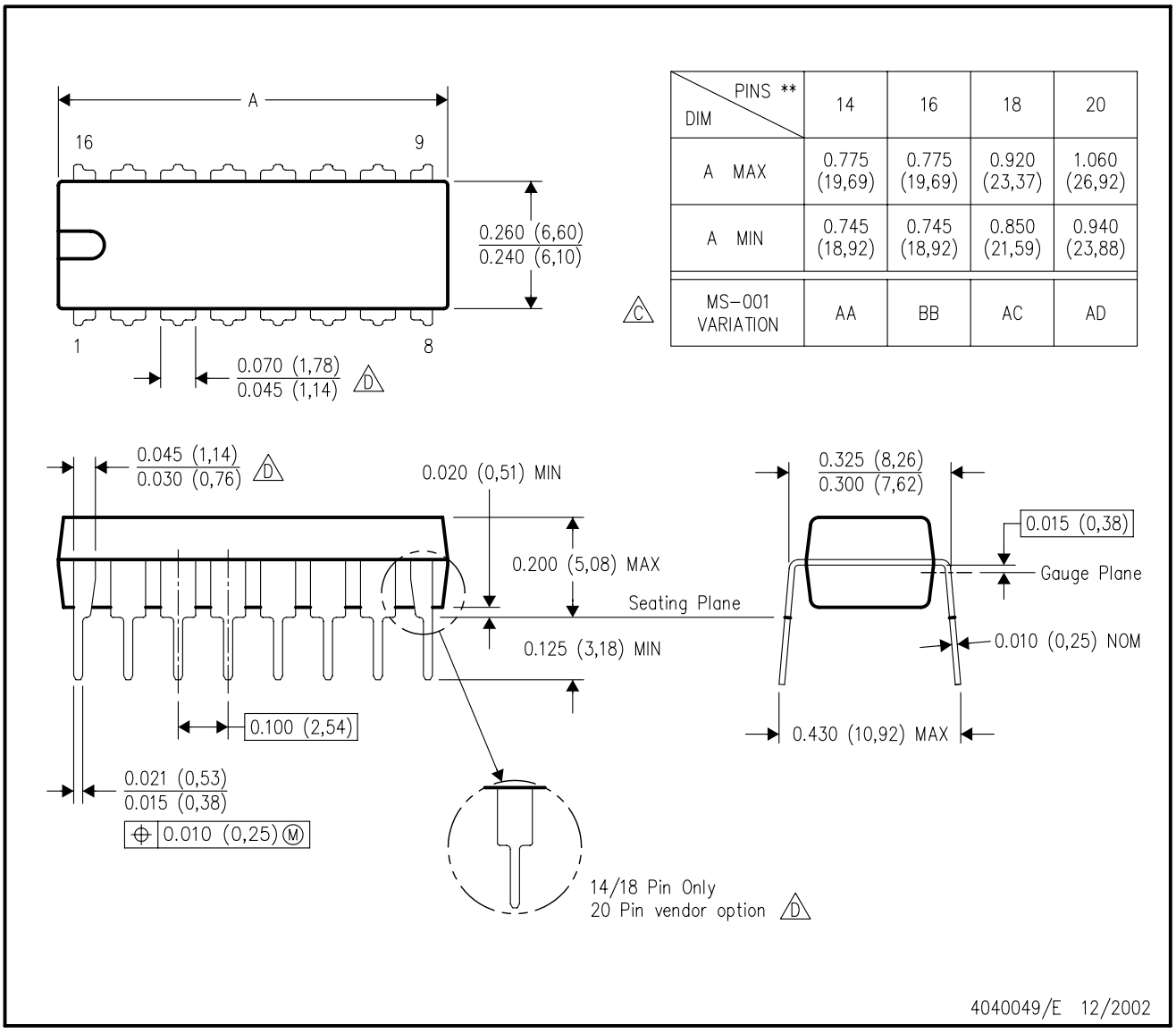
This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4229370VA\

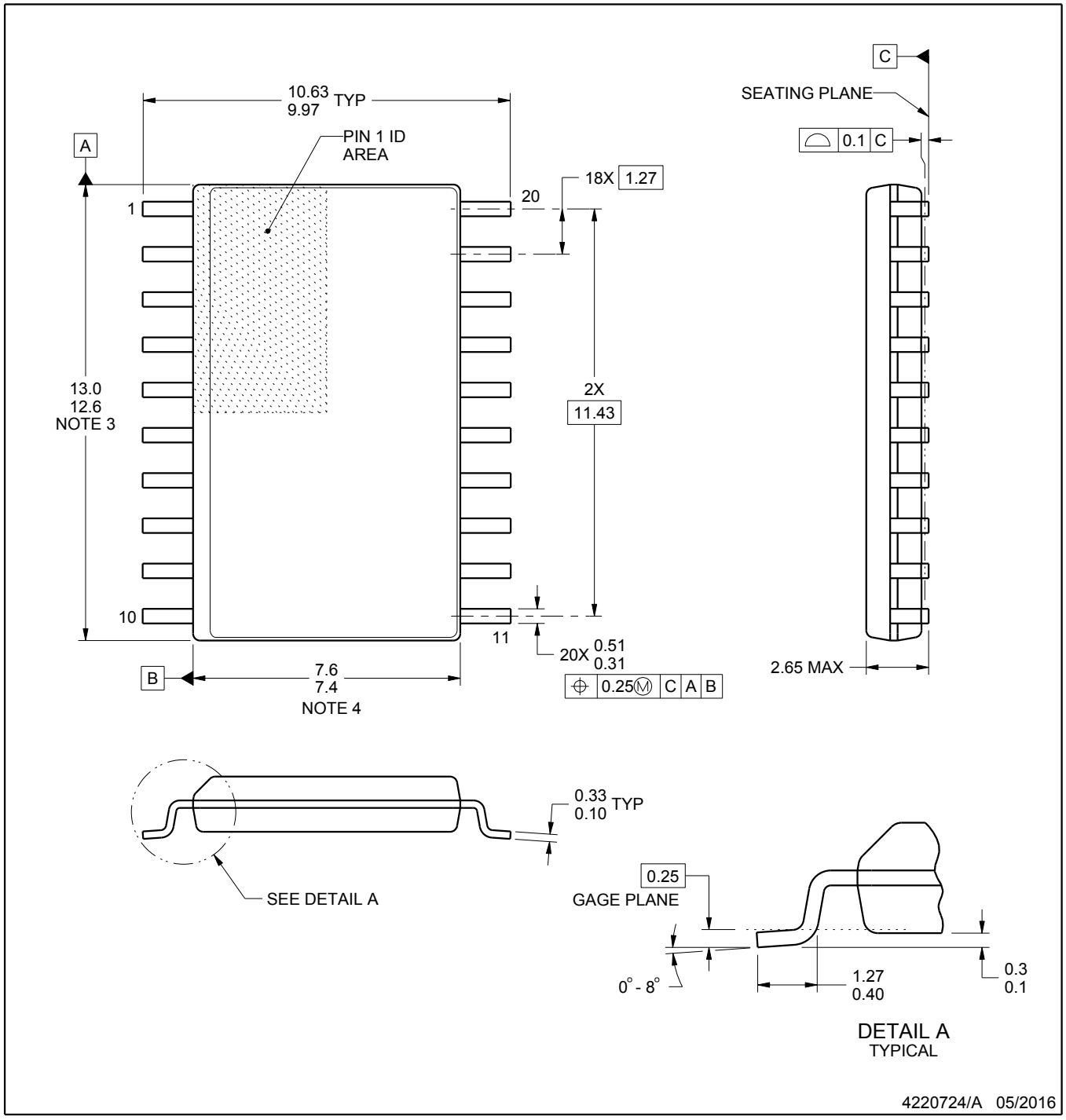
N (R–PDIP–T**) PLASTIC DUAL–IN–LINE PACKAGE

16 PINS SHOWN



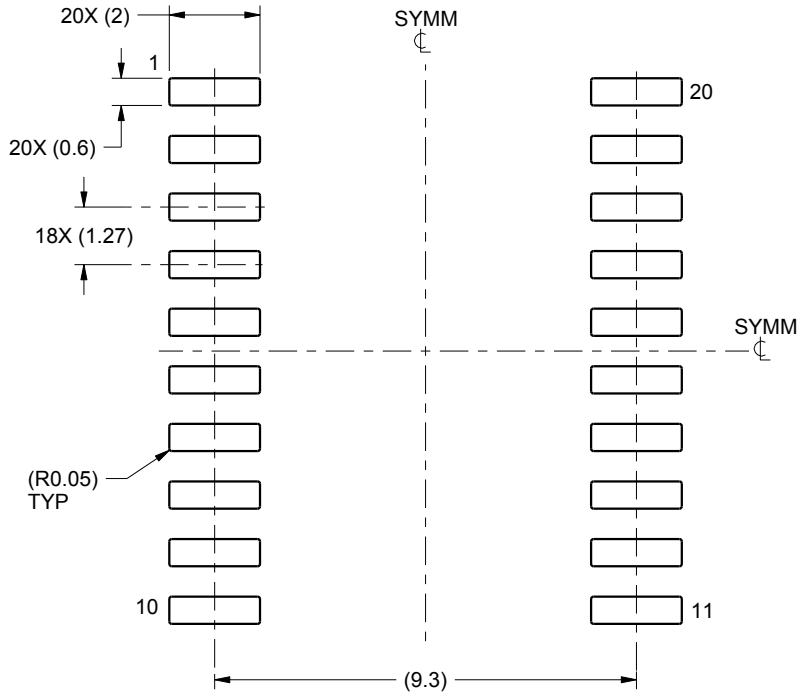
DIM \ PINS **	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS–001 VARIATION (C)	AA	BB	AC	AD

NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS–001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
D. The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

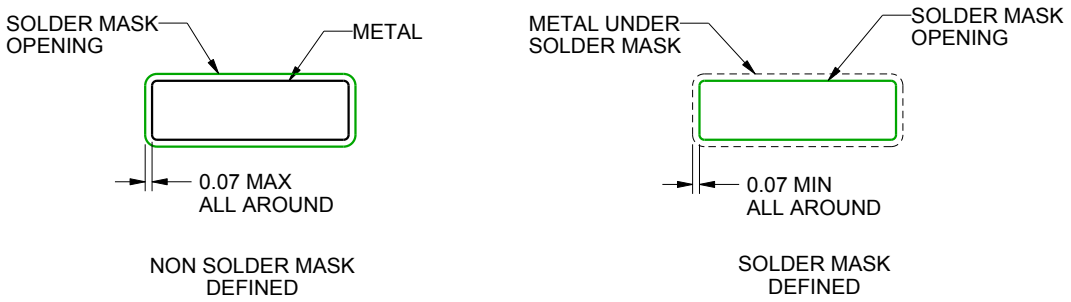


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X

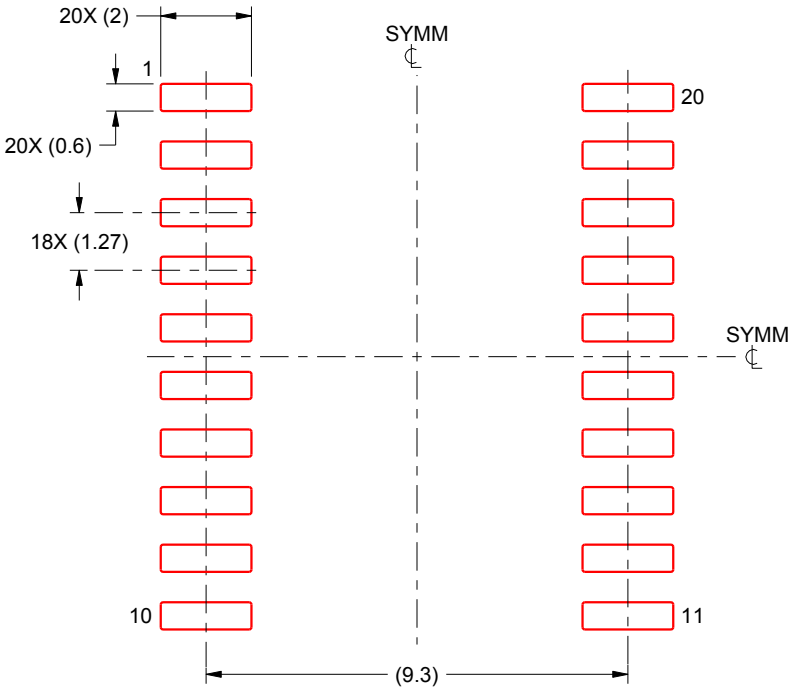


SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



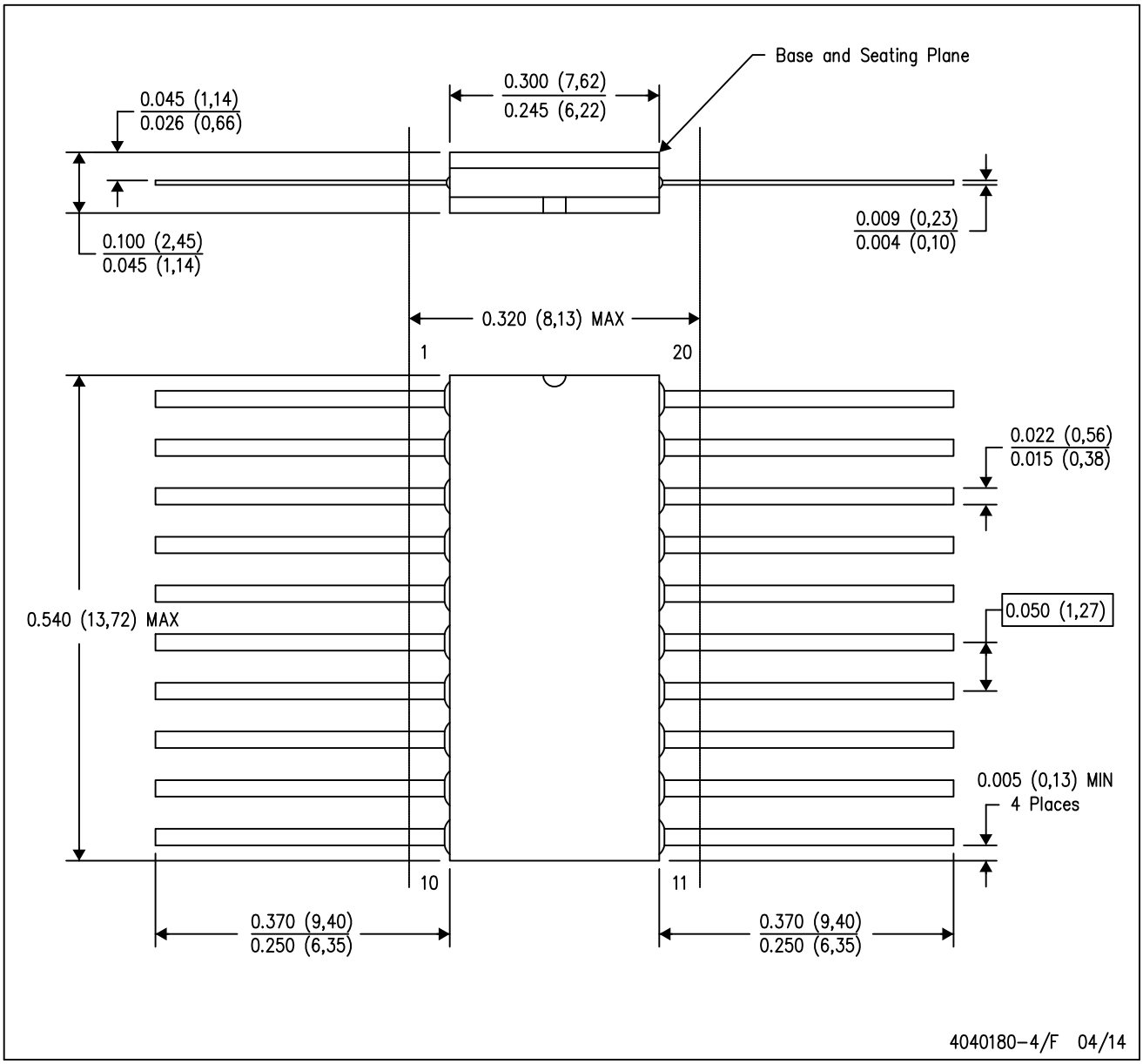
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

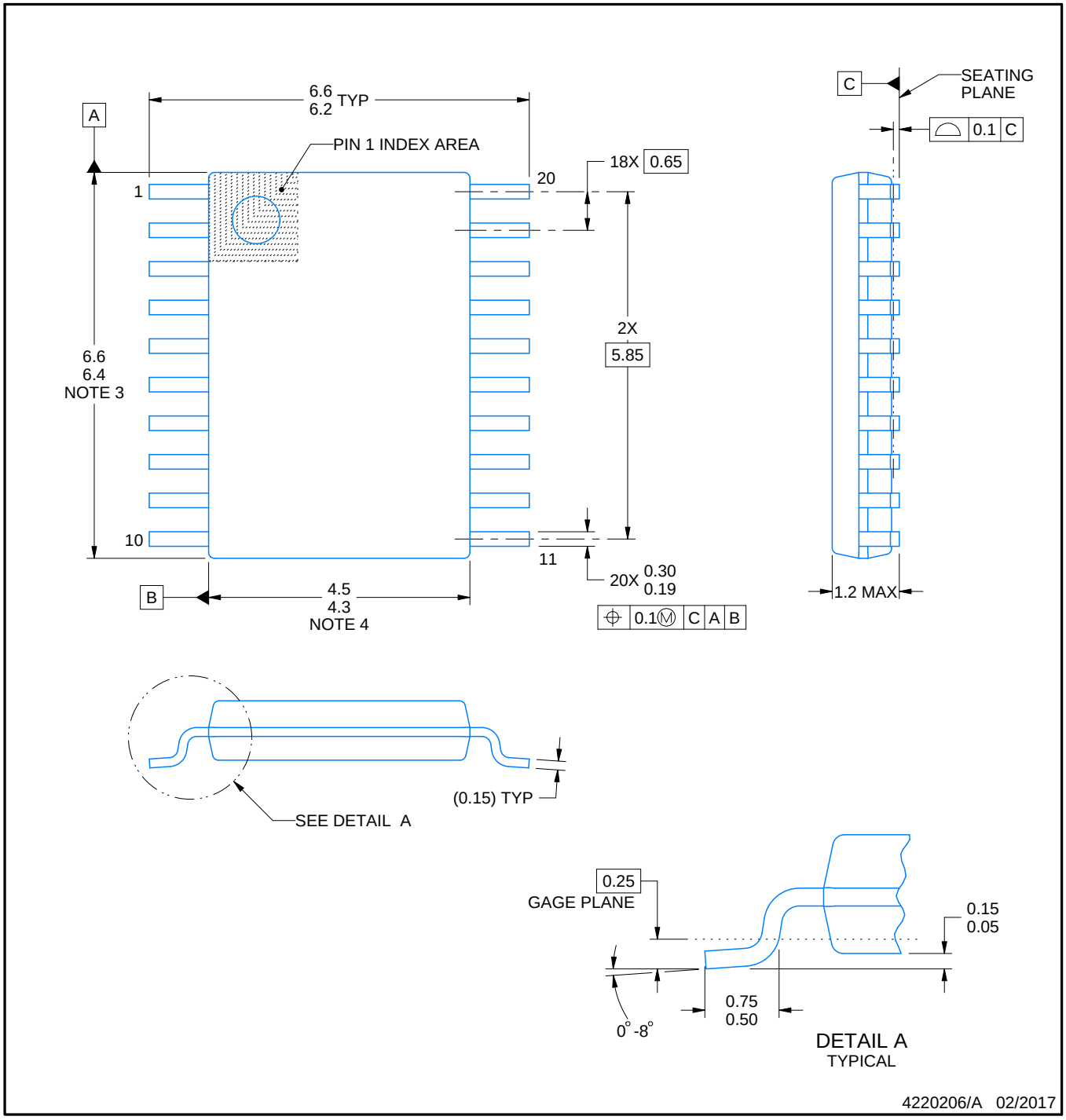
NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

W (R–GDFP–F20) CERAMIC DUAL FLATPACK

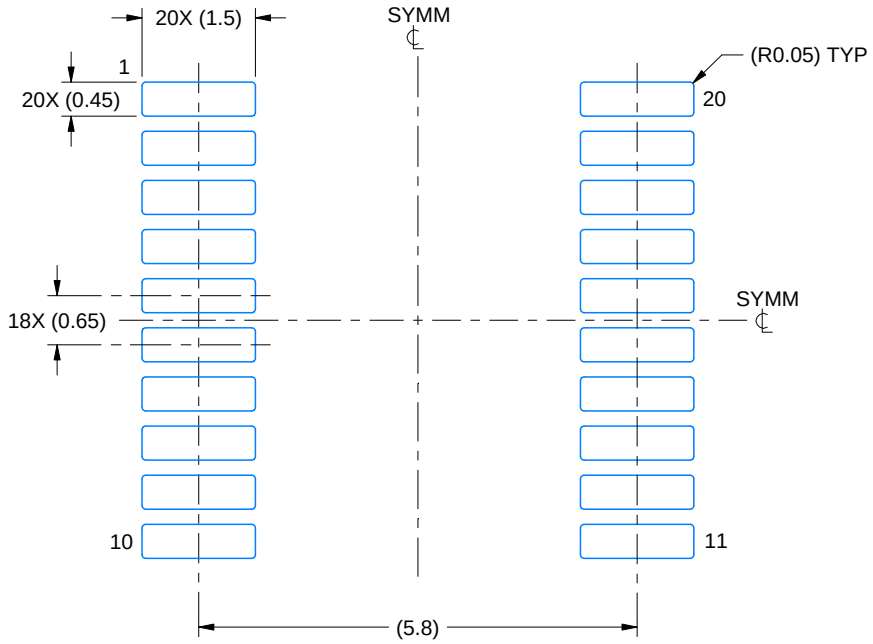


NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. This package can be hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
D. Index point is provided on cap for terminal identification only.
E. Falls within Mil–Std 1835 GDFP2–F20



NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

NON-SOLDER MASK DEFINED (PREFERRED)

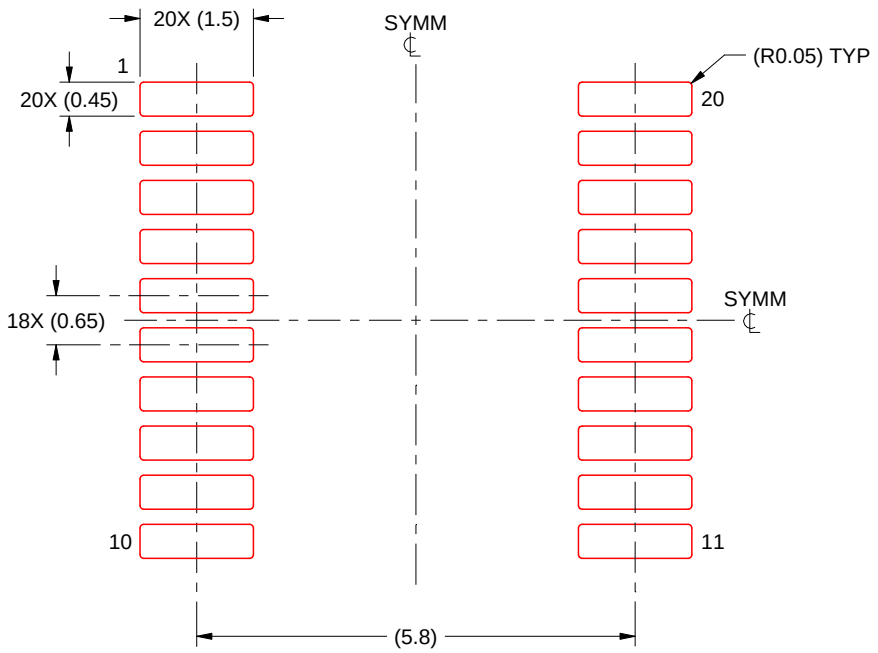
SOLDER MASK DEFINED

SOLDER MASK DETAILS

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月